

## 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“芯原股份”或“公司”）于2022年9月9日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，根据公司经营发展的需要，为更好地整合资源配置，提升研发及业务运营效率，明确权责体系，公司对组织架构进行了整合与优化。现将公司本次组织架构调整具体情况公告如下：

### 1、整合公司一站式芯片定制业务，设立“芯片定制平台事业部”

公司主营业务为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务，近年来公司服务的客户中系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等客户群体占比逐年增加，该类客户对包含软件的整体解决方案有较高的需求。为了顺应上述客户需求，公司将自身服务范围从硬件拓展至软件，为客户提供一站式系统平台解决方案，增加客户合作粘性并扩大公司业务发展空间。

基于此，公司进一步对原有一站式芯片定制业务相关组织架构进行调整，将原定制芯片业务事业部、设计IP事业部、系统平台解决方案事业部进行整合，并设立芯片定制平台事业部，负责开展公司一站式芯片定制业务，该部门由公司副总裁汪志伟先生负责。随着上述整合工作的完成，将有利于公司一站式芯片定制业务的统筹发展，提升公司研发效率以更加高效地响应客户需求，为客户提供优质的一站式系统平台解决方案。

上述整合完成后，公司研发相关部门架构及权责分工如下：

部门名称	主要职责	负责人
IP 事业部	负责公司半导体 IP 授权业务 相关技术研发工作	Wei-Jin Dai（戴伟进）
芯片定制平台事业部	负责公司一站式芯片定制业务 相关研发工作	汪志伟

## 2、整合公司运营工作，设立“业务运营部”

基于公司日常业务发展及运营工作需要，公司设立业务运营部，将原运营部、采购部、市场部、销售支持部项下中国区销售及支持职能，以及公司其他业务运营相关职能进行了整合，新设业务运营部将由公司副总裁汪洋先生负责。随着上述整合，汪洋先生将负责公司业务运营事宜，进一步提升公司供应链管理能力及运营效率，同时也有利于公司中国区业务的开展。

除上述主要调整外，公司也基于内部管理需要对其他部门设置进行了整合或调整，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2022年9月10日

附件：芯原微电子（上海）股份有限公司组织架构图

